

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20240911

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：
参与单位名称 及人员姓名	海通证券：肖隽翀；国泰君安证券：文越、应佳等 3 名投资者及证券人员
时间	2024 年 9 月 11 日下午 14:00-15:30
地点	公司 9 楼会议室
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书杨平彩女士
投资者 关系活动 主要内容 介绍	<p>管理层介绍公司基本情况，并与投资者就公司半导体材料业务、打印复印通用耗材业务的经营及其他投资者关心的问题进行深入交流，主要交流内容如下：</p> <p>问 1：公司 CMP 抛光垫产品放量情况如何，增长原因有哪些？</p> <p>答：公司 CMP 抛光垫在今年上半年实现产品销售收入 2.98 亿元，同比增长 99.79%；其中今年第二季度实现产品销售收入 1.63 亿元，环比增长 21.23%，同比增长 92.03%，创历史单季收入新高。一方面，公司抛光垫产品在国内核心晶圆厂客户端的覆盖程度及渗透水平持续提升，包括硬垫产品在逻辑晶圆厂客户的技术节点、制程占比及客户范围持续扩大，以及软垫产品生产、销售持续稳定爬坡提升。另一方面，国内半导体产业下游需求旺盛，随着产业规模的增长、下游晶圆厂客户的扩产，以及制程工艺节点的进步、芯片堆叠层数的增加，抛光步骤和 CMP 耗材用量将会增加，对公司 CMP 抛光垫产品的放量有促进作用。公司将努力保持 CMP 抛光垫业务较好的季度环比增长态势。</p> <p>问 2：公司在 CMP 抛光垫领域有哪些积累？</p> <p>答：公司是国内唯一一家全面掌握 CMP 抛光垫全流程核心研发技术和生产工艺的 CMP 抛光垫供应商，现已确立 CMP 抛光垫国产供应龙头地位，在该产品领域形成了较强的综合竞争实力。主要包括：1、产品型号齐全，公司 CMP 抛光垫产品类型覆盖硬垫、软垫，应用节点从成熟制程开始持续扩展。2、供应链管控能力强，核心原材料自主化持续推进，这有助于保障</p>

产品品质稳定可控，同时提升产品的潜在盈利空间。3、生产工艺持续进步，良率、效率提升，损耗减少，降低成本。4、CMP 环节核心耗材一站式布局方案逐步完善，系统化的 CMP 环节产品支持能力、技术服务能力、整体方案解决能力持续提升。

问 3：公司半导体显示材料情况如何？

答：今年上半年，公司半导体显示材料实现产品销售收入 1.67 亿元，同比增长 232.27%；其中今年第二季度实现产品销售收入 9,707 万元，环比增长 38.24%，同比增长 160.53%，并于 6 月首次实现单月销售额突破 4,000 万元，创单月收入新高。目前，公司 YPI、PSPI、TFE-INK 产品已在客户端规模销售，并已成为国内大部分主流显示面板客户 YPI、PSPI 产品的第一供应商，确立 YPI、PSPI 产品国产供应领先地位。未来，公司将继续努力推动显示材料产品在面板厂客户端渗透水平的提升，抓住 OLED 显示面板行业下游需求旺盛、中大尺寸应用有望放量，国内 OLED 产能持续快速增长的机遇，促进公司显示材料业务收入保持快速增长态势。

问 4：公司半导体显示材料新品开发验证情况怎样？

答：公司围绕柔性 OLED 显示屏制造用的上游核心“卡脖子”材料布局，同时对标国际一流共同探索未来显示技术工艺路线及相应材料应用方向，努力成为新型显示前沿技术的创新材料支持商。目前有无氟光敏聚酰亚胺（PFAS Free PSPI）、黑色光敏聚酰亚胺（BPDL）、薄膜封装低介电材料（Low Dk INK）等半导体显示材料新品按计划开发、送样中。

问 5：公司 CMP 抛光液、清洗液业务发展情况如何？

答：今年上半年，公司 CMP 抛光液、清洗液实现产品销售收入 7,641 万元，同比增长 189.71%；其中今年第二季度实现产品销售收入 4,048 万元，环比增长 12.68%，同比增长 177.03%。已有多款 CMP 抛光液产品在晶圆厂客户端稳定供货，订单量不断增长，仙桃产业园抛光液及抛光液用配套纳米研磨粒子规模化产线也开始在客户端规模供应，为 CMP 抛光液产品持续放量打下坚实基础。铜 CMP 后清洗液也在国内多家客户持续形成规模销售。公司将继续做好抛光液与清洗液新产品的持续验证工作，随着下半年新产品订单继续产出，努力推高该业务全年销售收入。

问 6：公司高端晶圆光刻胶业务进展怎样？

答：公司高端晶圆光刻胶业务快速推进，整体测试进展顺利，已有部分产品进入加仑样验证阶段。原材料自主化、品管体系完善、产线建设等工作同步快速进行。公司已打造全流程开发模式，自主解决部分核心原材料供应问题，从自主设计的核心功能单体到树脂、PAG 和 Quencher 等核心原材料均自主开发；同时在国内寻求有实力的合作伙伴，有力保障供应链的安全。已初步搭建全链条、全过程、全员参与的三位一体的预防性质量管理体系，并建立起先进的光刻胶检测分析实验室和应用评价实验室来保障产品质量的一致性和可靠性。在产能方面，潜江一期年产 30 吨高端晶圆光刻胶量产线已进入试运行阶段，目前整体运行状态良好。二期年产 300 吨高端晶圆光刻胶量产线建设按计划推进中。

	<p>问 7：公司半导体封装材料推进情况如何？</p> <p>答：半导体封装 PI 方面，公司已布局 7 款产品，全面覆盖非光敏 PI、正性 PSPI 和负性 PSPI，并已送样 5 款，在 2024 年上半年内完成部分产品的验证并开始导入，上半年完成 3 家客户的稽核，并取得了首张批量订单，形成了业务突破。此外，临时键合胶产品在国内某主流集成电路制造客户端的验证及量产导入工作基本完成，有三家以上晶圆厂客户和封装客户已完成技术对接，根据部分客户的需求正在进行内部验证中。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 9 月 11 日